

证券代码：000988

证券简称：华工科技

华工科技产业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-03

日期：8月27日

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 业绩说明会 ☐ 现场参观	☐ 分析师会议 ☐ 新闻发布会 ☒ 其他（电话会议）	☐ 媒体采访 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	1、华夏基金 2、广发基金 3、富国基金 4、兴业基金 5、融通基金 6、长城基金 7、太平资产管理 8、太平基金 9、德邦基金 10、百嘉基金 11、前海开源基金 12、中信保诚资产管理 13、国泰君安证券资产管理 14、BroadPeak Investment Limited 15、UG Investment Advisers 16、LST Capital Partners Consulting Limited 17、上海国际信托 18、环球电信资本合伙控股 19、第一上海创业投资管理(深圳) 20、上海森锦投资 21、深圳中安汇富私募证券基金 22、深圳市景元天成投资顾问		

	23、深圳市岭南资本(控股)
	24、深圳前海辰星私募证券投资基金
	25、上海衡策投资
	26、道明资产管理
	27、上海大朴资产管理
	28、北京阳光天泓资产管理
	29、湖南源乘私募基金
	30、瀚伦投资顾问(上海)
	31、耕零（上海）投资
	32、江西金投私募基金
	33、宁波耀松投资
	34、上海行知创业投资
	35、上海同犇投资管理中心
	36、重庆德睿恒丰资产管理
	37、福州开发区三鑫资产管理
	38、恒洵投资
	39、汇瑾资本
	40、广州同泽投资管理
	41、野村國際（香港）
	42、国泰海通证券
	43、中金证券
	44、中信证券
	45、中信建投证券
	46、华泰证券
	47、申万宏源证券
	48、天风证券
	49、招商证券
	50、广发证券
	51、兴业证券

	52、瑞银证券 53、民生证券 54、东方财富证券 55、中银国际证券 56、开源证券 57、国海证券 58、国盛证券 59、国金证券 60、山西证券 61、第一上海证券 62、东吴证券 63、爱建证券 64、天府证券 65、中天证券 66、每日经济新闻 67、个人投资者
时间	2026 年 8 月 27 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、华工科技 董事/副总经理/董事会秘书：刘含树； 2、华工科技 董事/副总经理：熊文； 3、华工高理 总经理：聂波； 4、华工正源 总经理：胡长飞； 5、华工激光 副总经理：王建刚； 6、华工科技 总经理助理：李慧； 7、华工科技 证券事务代表：姚永川； 8、华工科技 投资者关系主管：陶雪芷
投资者关系活动主要内容介绍	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	调研活动安排

附件：

投资者交流会议纪要

一、公司 2026 年上半年经营业绩及发展情况

公司积极引领行业发展，围绕客户需求持续创新，聚焦“光互联、智能感知、智能制造”三大核心业务，面向国内、国际两大市场，聚焦 AI 基础支撑、产业数智化赋能，持续推动关键核心技术突破，打造“全球首发、行业领先、专精特新”产品。报告期内，公司实现营业收入 78.22 亿元，同比增长 2.53%，归属母公司净利润 11.86 亿元，同比增长 30.17%。

光互联业务：报告期内，公司光互联业务实现营业收入 38.03 亿元，净利润 2.75 亿元，同比增长 18%，其中 AI 高速光互联业务营收实现快速增长。公司 800G、1.6T 系列高速光模块实现全球化、规模化交付，客户结构持续优化，市场交付份额稳步提升；技术迭代方面，公司率先完成 3.2T NPO 产品研发并于国际行业展会完成动态首展；推出 6.4T NPO 解决方案；行业首发 200G/Lane 架构 12.8T XPO 样品，产品核心性能行业领先。Q2 公司光互联业务收入利润增速放缓，主要系高端 1.6T DSP 及 800G LPO Driver 等核心物料紧缺影响。二季度公司完善了一系列改进工作，一是自动化产业的导入基本完成；二是质量管理的改善，以及高端产品的工艺改进；三是国产 DSP 的导入快速推进；四是关键物料的锁定，特别是海外高端 DSP 芯片。

智能感知业务：报告期内，公司智能感知业务实现营业收入 18.79 亿元，净利润 2.03 亿元。公司稳步实现由单一温度感知向多维集成智能感知解决方案转型，智慧家居、新能源汽车、光伏储能三大支柱市场结构持续优化。汽车业务基本盘稳固，与国内主流车企保持长期深度合作，客户结构动态优化，新项目定点与量产成果丰硕。压力传感器产业化提速，销售收入显著增长，成功进入多家一线车企供应链。光伏储能第二增长曲线取得大幅增长，CCS 集成母排温度传感器顺利切入头部储能供应链。冷媒气体传感器实现全球家电头部客户批量供货。全球化市场与海外产能布局提速增效，海外业务持续增长。上半年智能感知业务收入利润有所下降，主要受新能源汽车行业承压降价影响。

智能制造业务：报告期内，公司智能制造业务实现营业收入 19.29 亿元，同比增长 15%；净利润 2.66 亿元，同比增长 12%。宏加工业务聚焦新能源与智能

制造两大优质赛道，新能源汽车、船舶等五大行业订单占比达 89%。船舶行业，大幅面坡口切割/锌粉划线智能装备、喷墨划线智能装备订单同比增长 285%。三维五轴激光装备持续扩大海外头部客户市场份额。微加工业务向行业产品驱动深化发展。激光 PCB 打孔装备已在多家头部客户验证，TGV 激光打孔已有 Demo 级，正进一步优化；3DP 增材智造构建“装备+服务”双轮驱动模式，服务已实现行业客户批量订单及交付；绿色智慧农机完成小批量量产和工程样机开发，实现国内外市场突破；SiC 退火设备实现订单复制。公司持续推进“激光+AI”产品升级和全球化布局，为智能制造发展提供核心支撑。

研发创新：公司持续加大研发投入、强化人才支撑，以“全面拥抱 AI、深度融入 AI”为核心方针，发力“感传知用”全栈 AI 能力。报告期内公司研发投入 5.99 亿元，同比增长 29.89%，主要用于新产品开发。围绕公司未来发展的新技术、新产品的研发投入的力度增强，研发投入占比提升至 7.66%，较去年同期进一步增长。

全球化经营：公司坚定不移推进全球化经营战略，海外业务快速增长，上半年公司实现海外收入 16.48 亿元，占总收入的比重达到 21%，较去年同期增长 115.67%，主要来自北美及东南亚地区的增长。

二、交流问答

1、请问公司光互联业务物料供应情况与展望？

答：公司上半年光互联业务交付受到关键物料缺货的制约，主要是受行业格局影响，高端 1.6T DSP 芯片供应紧张，同时受全球半导体产能影响，800G LPO Driver 供应紧张。针对上述情况，公司已采取一系列应对措施：一是完成国产 DSP 导入，形成“海外业务、国内头部互联网厂商、以国产 DSP 交付国内互联网厂商及算力代建客户”的格局；二是对关键物料提前锁定备货，库存相应增加；三是光芯片自给能力提升，公司发起设立的上游芯片厂商云岭光电光芯片、CW 光源已实现量产并批量交付。上半年公司光互联业务 800G、1.6T 光模块受核心物料到货影响，实际交付数量不及预期的 50%，供应链紧缺的问题在 Q3、Q4 将得到显著改善，其中 800G LPO Driver 交付得到改善，1.6T DSP 跟催到货中，7-8 月实际供应链齐套率已恢复至 70%。

2、请问公司光互联业务在手订单及海外市场进展如何？

答：客户需求持续旺盛，公司下半年国内在手订单已超过 60 亿元人民币，目前还在增加中，海外 800G LPO、1.6T 订单超过 2 亿美金。

1.6T FRO/LRO 作为海外市场主流产品，公司目前已在海外头部 AI 厂商测试中，预计 11 月会有测试结果反馈；NPO 产品目前与国内外多家头部 AI 厂商小批交付和细化确定最终方案；LPO 产品方面，800G LPO 下半年需求 50 万只，明年在手订单 100 万只；1.6T NPO 头部客户需求指引 500 万只。

3、面对国内外光模块订单增长需求，公司的产能准备情况如何？

答：海外产能方面，一期月产能 20 万只，其中 1.6T 约 2 万只，800G 约 18 万只；二期新增用地近 100 亩，预计明年下半年厂房建设完成后，海外月产能将新增 80 万只，其中 800G 月产能可提升至约 30 万只，1.6T 月产能可提升至 50 万只。国内产能方面，武汉地区未来城园区本年度也在加紧 800G 和 1.6T 产能建设。到本年末 800G 月产能可由当前 35-40 万只提升至 80-100 万只，1.6T 月产能可由当前 4 万只提升至 20 万只。

4、请问 NPO 方案的优势以及公司 3.2T NPO 的进展情况？

答：NPO 因其在产品良率、直通率、综合性价比，以及在测试的效率和便捷性上较 CPO 具备一定优势，故其发展速度将进一步加快，预计明年海外市场将有几百万套的需求，国内市场需求亦将达到百万套以上。公司已联合产业链率先开发 100G/Lane、200G/Lane 的 3.2T/6.4T NPO 产品，目前已在国内和海外头部 AI 厂商进行产品测试中。核心 OE 采用自研硅光，其性能和可量产性都具备先发优势；OE+外置光源模块（ELSP）已准备就绪，正在拉动小批量试制产线；同时持续加大 2.5D/3D 先进封装能力建设，并与外部先进封装厂商开展深度合作，同步启动产能扩充，为明年批量需求做好准备。

5、目前公司数通光模块中硅光应用的占比有多少？

答：数通光模块中硅光技术占比持续提升，目前公司硅光方案占比已达 70%-80%，EML 方案占比 20%-30%，硅光和 EML 的方案会并行推进。公司的硅光方案在 400G、800G、1.6T 的都是用的自研的方案。同时公司也在 FAB 厂推进从 8 英寸向 12 英寸晶圆的切换，以提升良率并降低成本。

6、如何看待 FCC 相关政策的不确定性对公司的影响？

答：FCC（美国联邦通信委员会）依据《通信安全法案》，2026 年传出拟将高速光模块纳入管控清单的草案，该草案尚未正式落地，受到美国云厂商、AI 企业强烈反对，存在修改、搁置、窄化范围的可能性。目前对公司尚无影响，公司将持续密切跟踪该事项的最新进展，提前做好相应预案，保障各项经营业务平稳开展。

7、请问公司半导体及 3D 打印业务的最新进展情况？

答：2026 年上半年，公司半导体业务板块收入大幅增长，聚焦光电芯片、SiC、存储芯片三大赛道开展市场布局。光电芯片半导体激光加工装备实现头部客户批量供货，SiC 装备完成批量产业化。存储芯片板块，公司高端晶圆激光加工装备成功导入世界级存储晶圆量产线，完成核心客户导入。公司将继续聚焦高端半导体激光加工核心赛道，深化化合物半导体及先进存储领域工艺创新，加速

推进自主创新与产业链协同，持续推进业务拓展。

3D 打印业务板块依托激光光源到加工工艺的全链条技术优势，聚焦 3C 消费电子与 AI 算力两大核心领域，3DP 增材智造构建“装备+服务”双轮驱动模式，装备推出八头激光装备、绿光增材打印装备、3DP-Cell 自动化产线，打印服务已实现行业客户批量订单及交付。3C 业务钛加工板块已获得多家主流终端品牌客户订单切入，AI 业务铜加工板块，光通信器件、服务器散热结构件已实现小批量落地供货。公司 3D 打印自动化产线装备已实现与国际一流竞品全面对标，在细分特色领域形成差异化技术优势，持续强化产品壁垒，拓宽下游应用场景。

8、请问公司在智能制造业务宏加工领域的布局及未来展望？

答：公司智能制造业务宏加工领域聚焦新能源与智能制造两大优质赛道，聚焦区域重点行业大客户，深耕汽车零部件等优势存量市场，紧抓船舶行业高端化、绿色化转型机遇，引领传统产业转型升级。同步开拓商业航天应用激光装备等新兴赛道，着力塑造第二增长曲线。以头部客户为牵引，做深做透欧洲船舶、北美汽车及东南亚轮胎三大核心市场，加速全球化布局，全力提升全球市场份额与品牌影响力。

9、国内新能源汽车行业承压，请问公司的应对策略以及未来的增长点有哪些？

答：目前国内新能源汽车行业竞争加剧、行业阶段性承压，公司主动调整经营策略，以产品高端化、客户多元化、市场全球化对冲行业周期风险，培育多极增长动能。公司将推动产品高端化升级，聚焦多合一集成传感器、压力传感器、MEMS 气体传感器、CCS、热管理系统、柔性加热膜、车载中央气源系统等高端产品，用高附加值产品对冲行业价格下行压力。同时持续推进客户结构优化升级，坚持大客户战略。跳出家电、汽车赛道开展业务多元化拓展，持续拓展光伏储能、低空经济、具身智能、AI 数据中心等新兴场景，打造多元业务布局。并加大海外市场开拓力度，国内市场深耕规模与份额，海外市场开拓高毛利增量，以海外业务增长平衡国内行业竞争压力。

10、请问公司 H 股上市的进展情况如何？

答：公司于今年 4 月 13 日向香港联交所正式递交了 H 股上市申请，于 4 月 15 日向中国证监会递交了境外发行上市备案材料，申请与备案均已获受理。公司本次 H 股募集资金将主要用于三方面：一是深化全球布局，拓展海外市场，募集资金将用于生产基地的建设，有助于公司更好地深入国际市场、提升供应链韧性，为海外业务的持续拓展提供坚实的产能支撑。二是强化创新驱动，提升核心竞争力，通过产品迭代，聚焦下一代超高速光模块、MEMS 系列传感器、智能农机、中央研究院创新能力提升等新产品和项目，为公司可持续快速发展注入持久动力。三是拓宽融资渠道，保障运营韧性，补充流动资金将有助于优化财务结构。